

2025年4月15-17日

上海新国际博览中心

# 2025第三代半导体技术与产业链创新发展论坛

2025 Innovation Forum on the Advanced Power Semiconductors Technology and Industry Chain



## 基本信息 General Information

<b>会议时间 : Date :</b>	2025年4月15日 Apr 15,2025
<b>会议地点 : Venue</b>	上海新国际博览中心 Shanghai New International Expo Center
<b>主办单位 : Organizer :</b>	慕尼黑展览 ( 上海 ) 有限公司 Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd.
<b>会议语言 : Language :</b>	中文或英文 , 现场不提供同声传译 ( 建议英文演讲嘉宾使用双语PPT ) Chinese or English, no simultaneous interpretation (Non-Chinese speakers are recommended to use bilingual slides)
<b>演讲资料提交 : Material Submission Deadline :</b>	-中英文演讲题目、演讲文简介和照片、250字演讲摘要提交 : 截止日期2025年1月15日 -演讲PPT提交 : 截止日期2025年2月28日 -Bilingual info of subject and speaker, presentation abstract of 250 words: 15 Jan, 2025 -Complete PPT submission: 28 Feb, 2025

## 主要议题 Topics

- 新型功率器件的技术发展  
Technical development of new power devices
- 宽禁带器件的开发与特性  
Development and characteristics of wide band gap devices
- 新型功率器件的应用  
Application of new power devices

# 2024 论坛议程回顾 2024 2024 Review of Agenda

B

时间Time	演讲题目Presentation	演讲嘉宾Speaker
7月8日 July 8	主题：聚焦前沿技术应用，支撑汽车&工业发展	
9:00-9:45	签到入场 Registration	
9:45-10:00	嘉宾致辞 Welcome Speech	
10:00-10:30	第三代半导体产业发展报告解读 Interpretation of the Third Generation Semiconductor Industry Development Report	高伟，第三代半导体产业技术创新战略联盟副秘书长 Wei Gao, Deputy Secretary General of China Advanced Semiconductor Industry Innovation Alliance
10:30-11:00	德州仪器推出先进的氮化镓智能功率模块，助力打造更小更高效的马达驱动器 TI released GaN IPM to help build compact, efficient Motor Drivers	张宏亮，德州仪器系统工程师 Hely Zhang, System Application Engineer, Texas Instruments
11:00-11:30	意法半导体碳化硅MOS的技术路线和中国市场策略 ST's Silicon Carbide MOS Technology Roadmap and Market Strategy in China	孙君颖，意法半导体，技术市场部经理 Junying Sun, Technical Marketing Manager, STMicroelectronics
11:30-12:00	第三代半导体发展现状、功率器件及模块封装趋势 The current development status of wide bandgap semiconductors and the trend of power device and module packaging	樊嘉杰，复旦大学青年研究员 Jiajie Fan, Youth Professor of Fudan University

时间Time	演讲题目Presentation	演讲嘉宾Speaker
13:00-13:30	碳化硅垂直式6/8英寸兼容外延设备国产解决方案 SiC Vertical 6/8" Compatible Epitaxial Equipment Domestic Solutions	韩跃斌，芯三代半导体科技(苏州)股份有限公司，执行总监 Hans Han, Executive director, SiCentury Semiconductor Technology (Suzhou) Co., Ltd.
13:30-14:00	SiC MOSFET技术创新，加速应用领域变革 SiC Technology Accelerates Innovation in Applications	郝欣，英飞凌科技中国有限公司，技术总监 Haixin, Senior Principle Engineer, Infineon Technology
14:00-14:30	安世半导体碳化硅 - 超高性能，赋能电气化和绿色节能的美好未来 Nexperia's ultra-high performance SiC, Enabling an electrified energy-efficient future	王骏跃，安世半导体，SiC产品市场战略副总监 Julian Wang, Associate Director of SiC Strategic Marketing, Nexperia
14:30-15:00	新一代SiC MOSFET，加速在光储充领域应用 The new generation SiC MOSFET accelerates its application in the field of optical storage and charging	TBD
15:00-15:30	功率半导体芯片和模块的研究与应用 Research and Application of Power Semiconductor Chips and Modules	刘昊，无锡芯动半导体科技有限公司SiC研发总监 Liu Hao, SiC R&D Director Of Wuxi XinDong Semiconductor Technology Co.,Ltd.
15:30-16:00	车规级SiC MOSFET 高温高压短路KGD测试与动态晶圆老化测试挑战及解决方案 Challenges and Solutions for High Temperature High Voltage Short-Circuit KGD & Wafer Level Dynamic Burn-in for Automotive Grade SiC MOSFETs	毛赛君，忱芯科技(上海)有限公司，创始人 Saijun Mao, Founder, UniSiC Technology (Shanghai) Co., Ltd.
16:00-17:00	圆桌对话/Panel Discussion 议题： 1.受新能源汽车等需求影响，以SiC/GaN为代表的第三代半导体材料发展迅速，目前真正的应用市场有哪些？潜在市场前景如何？ 2.SiC上车“三电系统”+800V高压平台有何优势&未来？ 3.加速大规模应用，尚存哪些瓶颈需要突破？国内外在技术等方面发展情况又如何？	

\*具体议程以现场为准 The specific agenda is subject to the actual situation

## 2024 现场盛况 2024 grand occasion



## 2024 听众抽样名单 2024 Audience sample list

观众人数：449人

Attendance : 449

单位名称	Company
西门子电气传动有限公司	Siemens Electrical Drives Ltd.
西门子数控南京有限公司	Siemens CNC (Nanjing) Co., Ltd
施耐德电气(中国)有限公司	SCHNEIDER ELECTRIC (CHINA) CO.,LTD.
上海电气集团	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO.,LTD.
上海电气风电集团股份有限公司	Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd.
罗克韦尔自动化(中国)有限公司	Rockwell Automation(China)Co.,Ltd.
杭州中恒电气股份有限公司	Hangzhou Zhongheng Electric Co., Ltd.
保定市尤耐特电气有限公司	Baoding UNT ElectricCo. Ltd.
阳光电源股份有限公司	Sungrow Power Supply Co., Ltd.
人民电器集团有限公司	People Electrical Appliances Group Co.,Ltd
伊顿(中国)投资有限公司	Eaton (China) Investment Co., Ltd.
台达能源技术上海有限公司	Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd.
宁波中车时代传感技术有限公司	Ningbo CRRC Times Transducer Technology Co., Ltd.
博世(中国)投资有限公司	Bosch (China) Investment Ltd.
电装智能科技(上海)有限公司	Denso Shanghai Smart Mobility Technology Co., Ltd.
安波福电气系统有限公司	Aptiv Electric Systems Co., Ltd.
上海云骥智行智能科技有限公司	Shanghai Yunji Zhixing Intelligent Technology Co., Ltd.
中国第一汽车集团有限公司	China FAW Group Corporation Limited.
上海李尔汽车系统有限公司	Shanghai Lear Automotive Systems Co., Ltd.
郑州宇通客车股份有限公司	Yutong Bus Co., Ltd.
华为技术有限公司	Huawei Technologies Co., Ltd.
大金(中国)投资有限公司	Daikin (China) Investment Co ,Ltd
上海三星半导体有限公司	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd .
宝山钢铁股份公司	Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.